

第66期 中間株主通信

▶2025年12月21日～2026年6月20日

事業部制の強みを活かし、
さらなる成長を目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、
平素より格別のご高配を賜り
厚く御礼申し上げます。

第66期第2四半期（中間期）の業績
及び今後の取り組みについて
ご報告申し上げます。



代表取締役社長
細江 正大

前年同期の赤字から黒字転換 －収益力の改善が進展－

当第2四半期（中間期）につきましては、電子基板事業において医療機器や産業機器向けFPC（フレキシブルプリント配線板）の販売が堅調に推移したことに加え、テストシステム事業においてセラミックス基板向け外観検査機及びFPC向け通電検査機の販売が増加したことから、売上高は前年同期に比べ増収となりました。損益は電子基板事業を中心とした収益性の向上や売上総利益率の改善により、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する中間純利益は黒字転換いたしました。

第3四半期以降の重点施策

電子基板事業では、医療機器や産業機器に加え、EMS事業の拡大による付加価値向上に取り組むとともに、宇宙・航空関連分野向けFPCへの市場開拓を進めてまいります。テストシステム事業では、通電検査機及び外観検査機の拡販を進めるとともに、AIを活用した検査精度及び欠陥検出能力の向上を通じて、半導体・素材関連市場への提案を強化してまいります。産機システム事業では、FA・ロボット・検査技術を活用した自動化ソリューションの提案を推進してまいります。鏡面研磨機事業では、既存設備の更新需要の取り込みを進めるとともに、保有する回転機構技術を活用した事業横断的な装置開発を推進し、新たな事業機会の創出と収益基盤の強化に取り組んでまいります。

第66期 中間業績ハイライト

売上高

1,782百万円
前年同期比
+10.9%▲

営業利益

83百万円
前年同期は
57百万円の損失▲

経常利益

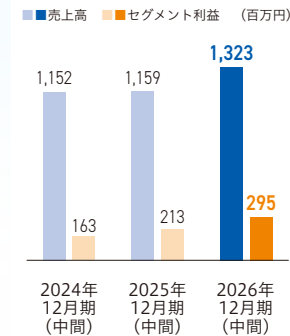
79百万円
前年同期は
59百万円の損失▲

親会社株主に帰属する中間純利益

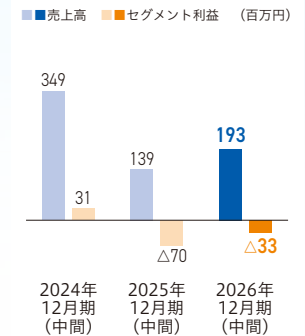
39百万円
前年同期は
65百万円の損失▲

セグメント別概況

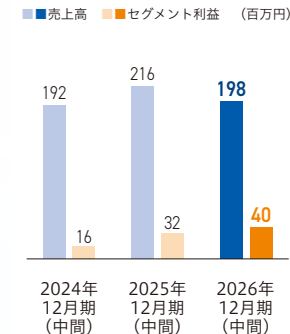
電子基板事業



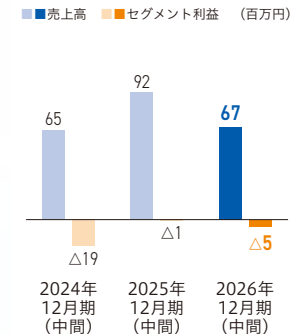
テストシステム事業



鏡面研磨機事業



産機システム事業



組織再編後の取り組みと成果

当社は2026年12月期より事業部制を導入し、各事業部が主体的に事業運営を行う体制へ移行いたしました。これにより、意思決定の迅速化や部門間の連携強化が進み、その成果が収益性の向上や新たな事業機会の創出として現れ始めております。各事業部における取り組みの成果と今後の成長戦略についてご紹介します。

電子部品事業部

機動力と生産性の向上

電子部品事業部では、FPCの製造・販売を主力事業として展開しております。事業部制導入により、事業部単位で意思決定が行えるようになったことで、お客様への迅速な対応や新規案件への柔軟な提案が実現いたしました。また、営業と製造を同一事業部内に配置したことで、部門間の連携がより一層強化され、情報共有の迅速化や業務プロセスの効率化につながっております。さらに、継続的に進めてきた製造工程の自動化設備への投資により、生産性向上と省人化体制の強化を図っております。

こうした取り組みにより、前年同期に比べ売上高及びセグメント利益が増加いたしました。今後もお客様の多様なニーズに応える提案力と対応力の強化を進め、事業の成長と収益力の向上に努めてまいります。

成長市場への展開を加速

電子部品事業を取り巻く市場環境は変化を続けており、高周波や半導体関連分野に加え、データセンター及び宇宙・航空分野を中心として中長期的に需要拡大が期待されております。当事業部では、医療機器や産業機器分野に加え、データセンターや宇宙・航空分野を重点市場と位置づけ、採用拡大に向けた取り組みを展開しております。その実現に向けて、高密度配線を実現する微細配線形成技術の一つであるMSAP(Modified Semi Additive Process)や高密度多層、高周波、耐熱・耐振動等の技術開発を推進し、各成長市場への技術展開を加速しております。また、自動化設備による更なる生産性向上に加え、EMS事業の拡大や海外展開を通して事業領域の拡大と競争力の強化を図り、持続的な成長を目指してまいります。

産業機器事業部

事業部連携によるシナジー創出

産業機器事業部では、外観検査装置及び通電検査装置並びにFAシステムの設計・販売を主力事業として展開しております。事業部制導入後は、営業と製造の情報共有や連携が活発化し、検査装置のお客様へのFA関連製品の提案や、ロボット技術を活用した新たなシステム設計等、事業領域を横断した取り組みを推進しております。また、検査装置分野の技術者がロボットを活用したソリューションの提案や設計に携わるなど、人材や技術の相互活用も進んでおり、設計力や対応力の向上に寄与しております。

こうした取り組みにより、お客様の課題解決に向けた提案力を強化し、新たな事業機会の創出や顧客接点の拡大につながっております。

高度化する自動化ニーズへの対応を推進

労働人口減少を背景に高まる省人化・自動化ニーズに対応するため、当事業部では画像処理技術やセンシング技術を活用した検査ソリューションの提案を推進しております。製造現場における品質向上と生産性向上の両立を支援するとともに、新たな市場・用途への展開を加速してまいります。現在、次世代半導体実装技術であるTGV(Through Glass Via)向け検査装置の開発に取り組んでおります。また、リードフレーム向けに外観検査と形状測定を組み合わせた新たな検査システムを開発中であり、高度な品質管理ニーズへの対応を強化してまいります。さらに、国内外の展示会への積極的な出展を通じて販路拡大を進めるとともに、検査技術とFA・ロボット技術を融合した付加価値の高いソリューションを提案し、持続的な成長を目指してまいります。

TOPICS トピックス

宇宙分野への取り組みを加速

当社は宇宙ビジネス総合展「SPEXA」に出展し、宇宙分野に向けた高信頼性基板を展示いたしました。また、株式会社尽星との連携のもと、宇宙環境下での使用を想定した環境試験の実施に向けた取り組みを開始しております。

今後も、極端な温度変化や放射線、振動等の過酷な環境に対応する高信頼性FPCの開発を推進し、宇宙分野における事業機会の創出を目指してまいります。



「SPEXA」出展の様子